

大山レポート

▶ COVER STORY

AIがもたらす 巨大半導体需要の中身と これから起きること

急膨張するデータセンタへの
投資の意外な「流れ先」

▶ GUEST PAPER

2030年商用化の6G通信システム、 安全保障上の懸念から東西分離へ

——米マサチューセッツ工科大学 アソシエートダイレクター 藤末健三氏

▶ NEWS REPORTS

ローム、デンソーと破談でEV一辺倒の経営方針を大転換
パワー半導体の3社統合から三菱が離脱か、残る2社の目論見と勝算

▶ MARKET DATA 世界半導体市場は79.2%増と爆増、NAND型フラッシュの需要が急拡大

世界半導体市場動向／ディスクリート半導体の市場動向／光半導体の市場動向／センサ/アクチュエータ半導体の市場動向／アナログICの市場動向／マイクロ(MPUとMCU)の市場動向／ロジックICの市場動向／メモリICの市場動向／半導体製造装置とメモリICの市況の相関／半導体製造装置の地域別出荷額／台湾TSMCの業績／米Intelの業績／米NVIDIAの業績／米AMDの業績／米Broadcomの業績／米Qualcommの業績／韓国Samsung Electronicsの業績／韓国SK hynixの業績／米Texas Instrumentsの業績／スイスSTMicroelectronicsの業績／独Infineon Technologiesの業績／ルネサス エレクトロニクスの業績／東京エレクトロンの業績／オランダASMLの業績／米Applied Materialsの業績／ファウンドリ企業のウエハ価格推移(40nm~130nm)／ファウンドリ企業のウエハ価格推移(16nm~28nm)／ファウンドリ企業のウエハ価格推移(5nm, 7nm)

大山レポート

2026年第2四半期号 No.8

【A4判 全32ページ】

CONTENTS

COVER STORY

AIがもたらす巨大半導体需要の中身とこれから起きること
急膨張するデータセンタへの投資の意外な「流れ先」……………3

NEWS REPORTS

ローム、デンソーと破談でEV一辺倒の経営方針を大転換……………11
パワー半導体の3社統合から三菱が離脱か、
残る2社の目論見と勝算……………12

MARKET DATA

世界半導体市場は79.2%増と爆増、
NAND型フラッシュの需要が急拡大……………13

世界半導体市場動向……………15
ディスクリート半導体の市場動向……………15
光半導体の市場動向……………16
センサ/アクチュエータ半導体の市場動向……………16
アナログICの市場動向……………17
マイクロ(MPUとMCU)の市場動向……………17
ロジックICの市場動向……………18
メモリICの市場動向……………18
半導体製造装置とメモリICの市況の相関……………19
半導体製造装置の地域別出荷額……………19

台湾 TSMCの業績……………20
米 Intelの業績……………20
米 NVIDIAの業績……………21
米 AMDの業績……………21
米 Broadcomの業績……………22
米 Qualcommの業績……………22
韓国 Samsung Electronicsの業績……………23
韓国 SK hynixの業績……………23
米 Texas Instrumentsの業績……………24
スイス STMicroelectronicsの業績……………24
独 Infineon Technologiesの業績……………25
ルネサス エレクトロニクスの業績……………25
東京エレクトロンの業績……………26
オランダ ASMLの業績……………26
米 Applied Materialsの業績……………27
ファウンドリ企業のウエハ価格推移(40nm ~ 130nm)……………27
ファウンドリ企業のウエハ価格推移(16nm ~ 28nm)……………28
ファウンドリ企業のウエハ価格推移(5nm、7nm)……………28

GUEST PAPER

2030年商用化の6G通信システム、安全保障上の懸念から東西分離へ
米マサチューセッツ工科大学(MIT) アソシエイトダイレクター 藤末健三氏……………29

NOTICE

- 「プロフェッショナルのための半導体情報 大山レポート」は、半導体やその関連材料、部材、装置などの製造、流通、調達に関わる担当者、そして半導体業界の調査分析に携わる投資家、金融機関、証券会社、調査会社、コンサルティング・ファーム、研究機関などを含む「プロフェッショナル」の方々のための半導体情報誌です。価格は8万8000円(税込)です。
- 年4回(3月、6月、9月、12月)の発行を予定しています。
- ご購入いただいた方には、下記のURLでの読者登録をお勧めしております。登録いただいた読者のみなさんには、編集長である大山 聡が提供するコンサルティング・サービスや登壇するセミナー、出演するYouTube番組などの情報を随時お届けします。(読者登録ページ URL <https://grossberg.jp/oyama-report/>)

次号予告(2026年第3四半期号 No.9、2026年9月発行予定)

「半導体製造装置/材料メーカー50社の通信簿」

※内容は変更になることがあります。

大山 聡 (おおやま・さとる)

グロスバーク合同会社 代表



慶應義塾大学大学院にて管理工学を専攻し、工学修士号を取得。1985年に東京エレクトロンに入社。1992年に日本データクエスト(現ガートナー・ジャパン)に入社し、半導体産業分析部でシニア・インダストリ・アナリストに就任。1996年にBZWジャパン証券(現パークレイズ証券)に入社し、証券アナリストとしてアドバンテスト、NEC、三洋電機、シャープ、ソニー、東京エレクトロン、東芝、ニコン、日立製作所、三菱電機、富士通、松下電器産業(社名はすべて当時)など大手電機メーカーの調査/分析を担当した。その後もエービーエヌ・アムロ証券、リーマン・ブラザーズ証券などで産業エレクトロニクス分野のアナリストとして活躍。日経アナリストランキング産業用電子機器部門で第4位(1999年)、第5位(2000年)。2004年に富士通に入社し、電子デバイス部門 経営戦略室の主席部長として半導体部門の経営戦略や分社化などを担当。2010年以降はアイサプ・ジャパン(2010年にIHSグローバルを買収、現在はOmdia)で半導体や2次電池をはじめとするエレクトロニクス分野全般の調査/分析を担当。2017年に調査およびコンサルティングを主務とするグロスバーク合同会社を設立して代表に就任(現職)。

プロフェッショナルのための半導体情報

大山レポート

2026年第2四半期号(2026年6月30日発行) No.8
ISBN978-4-9913715-9-2

編集長 大山 聡

企画編集 三好 敏 山下勝己(観濤舎)

校正 杉山典子(観濤舎)

クリエイティブディレクション 奥村敬正(TSTJ Inc.)

アートディレクション 出羽伸之(TSTJ Inc.)

デザイン 真崎琴実 星野絢香(TSTJ Inc.)

制作 TSTJ Inc.

発行 グロスバーク

発売 観濤舎

販売等に関するお問い合わせ

e-mail: oyama_report@kantosha.com

©2026 グロスバーク

<https://grossberg.jp/oyama-report/>

